

2024/06/01

Team

第六組

基金配置

Mentor

徐炤崑、阮謙益

AI+高成長科技基金

Members

白佳加、周家芃

賴俊佑、林哲安

李丞曜、黃以涵

Contents

1	基金簡介 & 投資邏輯	p.5
2	美國總經	p.8
3	雲端運算產業	p.13
4	半導體設備產業	p.27
5	附錄	p.44

結論

結論：看好未來高成長之雲端運算、半導體設備為主要配置

資產配置

- 目前客群鎖定喜愛高成長、高報酬率但需具備一定程度債券配置之投資人
- 股票（雲端、半導體）債券比 8：2，追求獲利的同時避免高成長股風險過大

美國總經分析

- 綜觀 CPI 及就業數據，通膨已逐漸有降溫趨勢，預期於今年 9 月份開始降息 1 至 2 碼
- 考量 Q4 開始降息循環，主要配置短債，以期進可攻（價差）退可守（領息）的局面

雲端運算產業

- 隨著 AI 生態系規模擴大，雲端計算服務應用已然成為各供應商未來發展重點項目
- 看好美國三大雲端應用龍頭：Microsoft、Amazon、Google

半導體設備產業

- 先進封裝蔚為風潮，一眾 CoWoS 應用引領半導體設備供應鏈營收成長
- 看好台系 IC 製造及封測設備廠商：弘塑、辛耘、牧德

基金簡介

1

基金簡介及配置邏輯

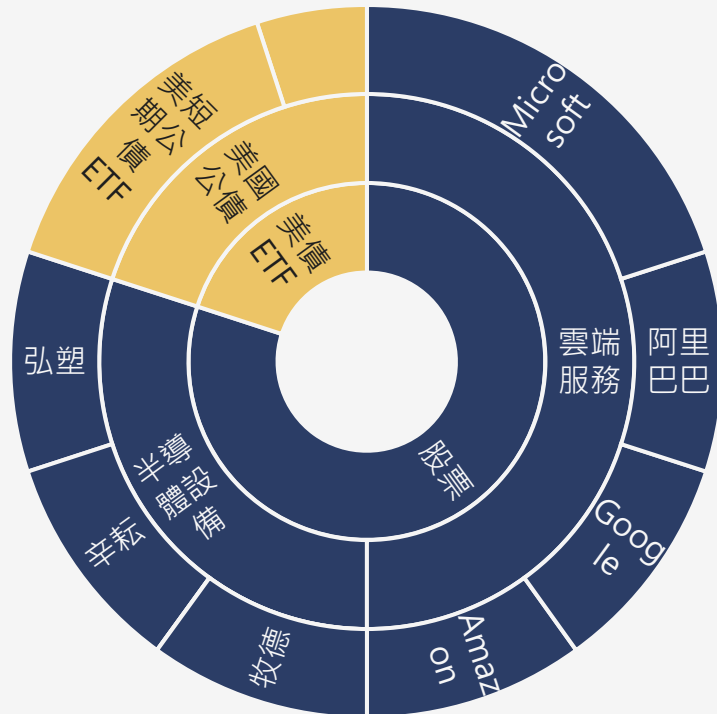
資產配置：以高成長產業為主，搭配公債獲取固定報酬

目標族群

追求高成長、高報酬且含股債配置的投資人

投資邏輯

80% 以高成長的雲端、半導體設備股票為標的，剩下則以美國短期公債獲取固定收益為主，長期公債獲取降息後資本利得為輔



投資區域

台灣、美國、中國

資產標的	代號	產業	佔比
美短期公債 ETF	SGOV	美國公債	15%
美長期公債 ETF	TLT	美國公債	5%
Microsoft	MSFT	雲端服務	15%
Amazon	AMZN	雲端服務	15%
Google	GOOG	雲端服務	15%
阿里巴巴	BABA	雲端服務	5%
弘塑	3131 TT	半導體設備	10%
辛耘	3583 TT	半導體設備	10%
牧德	3563 TT	半導體設備	10%

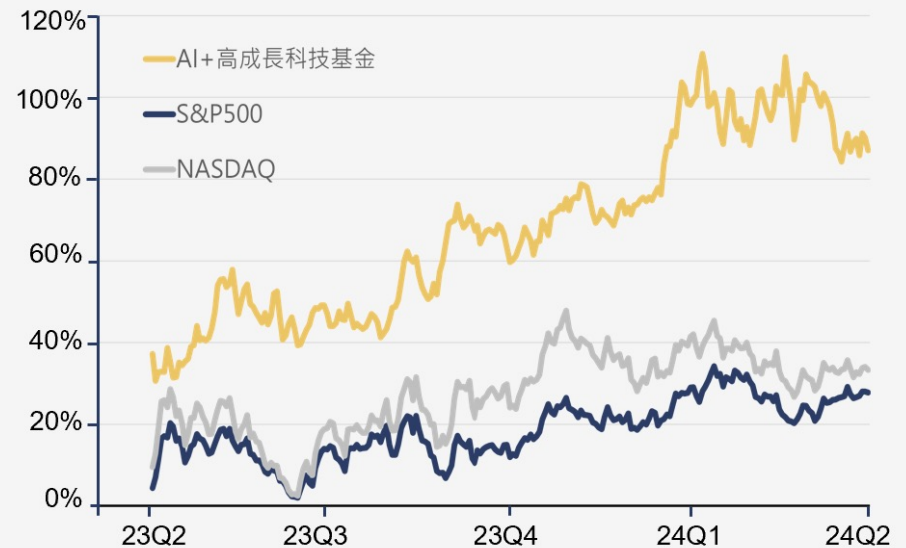
選股整合 AI 上下游供應鏈，納入潛力與櫃提供強勢成長動能

- 基金配置以 AI 供應鏈之中游供應商及終端應用為選股基準，納入受惠 AI 概念且本益比較低之潛力股，不錯過今年 AI 產業鏈之上下游整體成長。科技股為本波牛市主力，本檔基金亦納入高成長與櫃股票，帶動投資組合報酬績效持續高於大盤
- 配合 AI 產業鏈發展移轉，預期基金強勢表現將持續超過一年。展望未來，短期內科技股可能呈現高檔震盪格局，且配置比重達兩成之債券部位將提供下檔保護。考量長期，將配合未來央行降息策略，調整與再平衡債券部位佔比

AI 產業鏈上下游整體成長驅動強勢報酬表現

時間	報酬率
今年初至今	50%
3個月	23%
6個月	56%
1年	144%

本組基金近一年報酬績效持續優於大盤



總經

- 1 美國總經-就業
- 2 美國總經-消費
- 3 美國總經-債券配置
- 4 美國總經-結論

結論- 通膨趨於穩定，就業市場降溫，期待今年下半年開始降息

CPI、核心 CPI 年增率符合預期，通膨趨於穩定

- 4月份 CPI 年增率 (3.4%)、核心 CPI 年增率 (3.6%)，通貨膨脹趨於穩定。
- 核心商品逐漸降溫，通膨回落的過程正在進行。

4 月就業數據顯著轉弱，顯示就業市場開始降溫

- 4 月非農就業人口新增 17.5 萬人，低於市場預期的 24.0 萬人和前值 31.5 萬人。
- 4 月失業率由 3.8% 升至 3.9%，高於市場預期的 3.8%，就業市場逐漸轉弱。

預期今年 9 月份開始降息

- 在通膨穩定、就業市場降溫，期待 9 月份開始降息 1 碼，年內降息 2 碼。

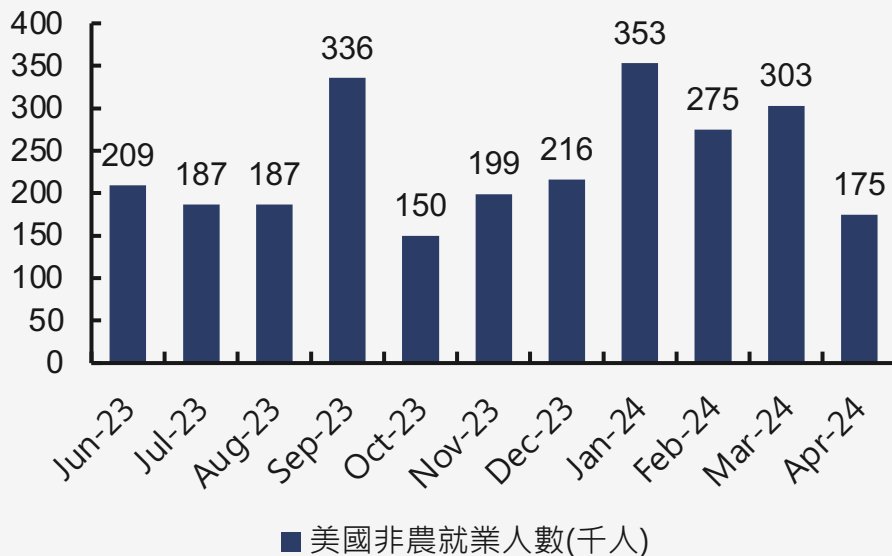
持有短債賺取高利息，持有中長債期待賺去資本利得

- 目前短債殖利率高(5.35%)，持有短債仍有不錯的回報。
- 期待降息能促使中長債殖利率下降，票面價格上升，賺取資本利得。

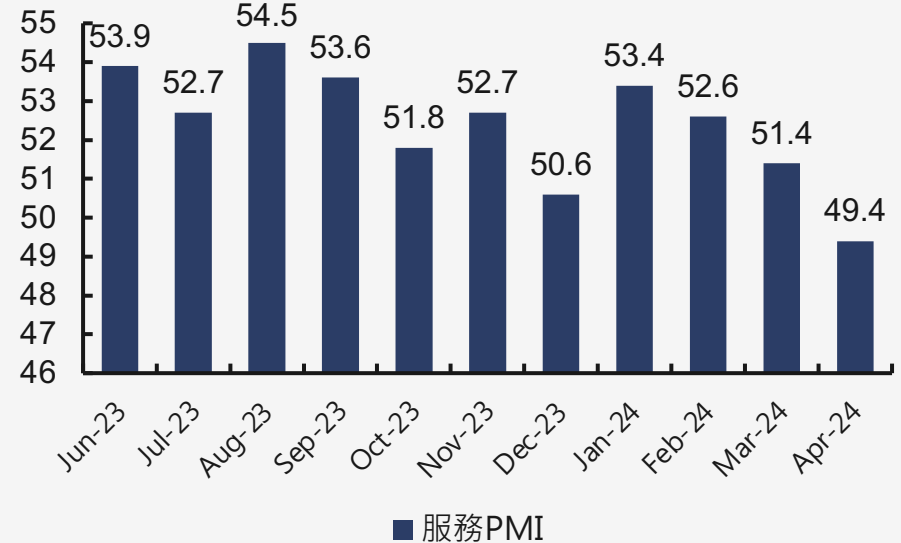
就業市場 – 4 月數據顯著轉弱，顯示就業市場開始降溫

- 美國 4 月非農就業人口新增 17.5 萬人，低於市場預期的 24.0 萬人和前值 31.5 萬人；4 月失業率由 3.8% 升至 3.9%，高於市場預期的 3.8%，平均時薪月增率由 0.3% 降至 0.2%，年增率由 4.1% 放緩至 3.9%，分別低於預期的 0.3%、4.0%，整體而言，4 月非農就業人數、失業率、薪資變化均出現放緩跡象。
- 數據顯示非農就業成長有 72% 來自於服務業支撐，而在服務業 PMI 持續下降且在 4 月分首度呈現萎縮情況，對就業市場降溫效果也更為顯著。

4 月非農就業人口低於市場預期



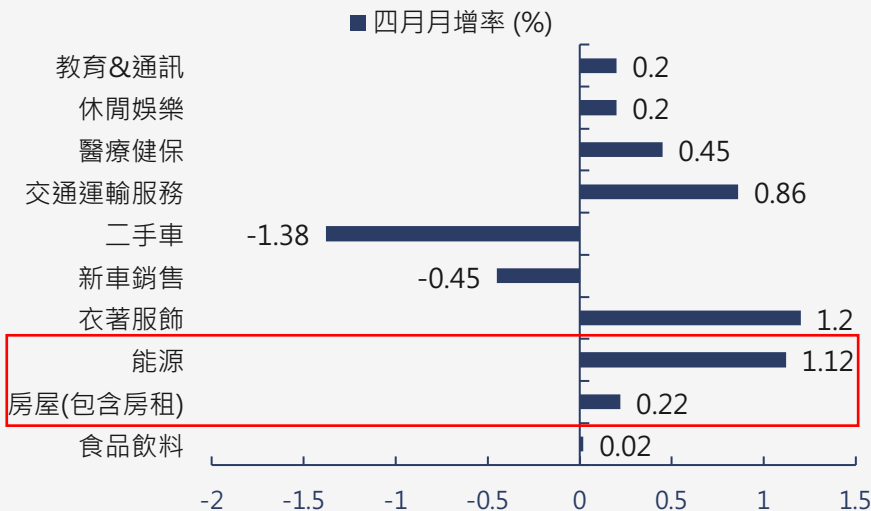
服務業 PMI 首度呈現萎縮



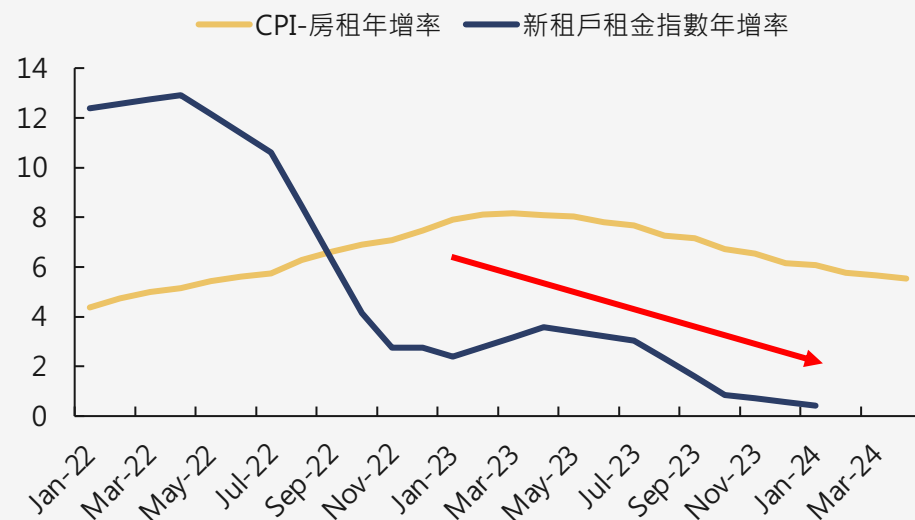
通膨雖短期仍僵固，但重回下降趨勢，核心房屋通膨將成關鍵

- 4 月 CPI 年增 3.4%，雖低於前值 3.5%，但通膨仍受能源價格以及居住成本上升而僵固，EIA 數據顯示，原油庫存上週減少 250 萬桶，使石油價格攀升。而房屋項 4 月年增 4.52%，顯示在高利率的環境下，新舊房屋貸款的鎖定效應導致舊屋主不肯賣房推動房價上漲，抵銷升息以及薪資水準降低需求對房價的影響，形成量縮價漲的趨勢
- 而 4 月核心 CPI 年增率為 3.6%，低於前值 3.82%，綜觀可見核心商品逐漸降溫，但仍需注意核心服務中，民眾就業、薪資水準及近期美國移民潮反映在房租的壓力，而新房租傳導至通膨的時間點將成為降息關鍵

美國 4 月 CPI 細項



新租戶租金滑落將能傳導至房屋通膨



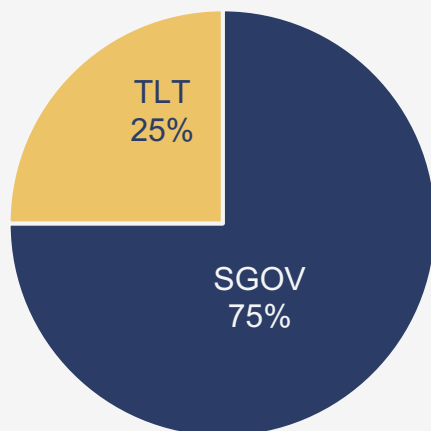
債券配置 - 預期今年內開始降息，佈局長、短債平衡收益

- 高利率環境，持有短期債券就有不錯的報酬，今年內預期降息 1 至 2 碼，仍然是相對是在利率高點，短期債券依然擁有相對優勢。
- 今年開始降息，期待能促使長期債券殖利率下降，債券票面價格上升，並藉此賺取資本利得。

配置 TLT、SGOV 作為長、短債部位組合

	TLT	SGOV
定義	20 年期以上長期公債ETF	0-3月短期公債ETF
殖利率	4.65%	5.35%
投資策略	目前短債仍有不錯的殖利率，長債期待能因價格上漲賺取資本利差。	

利率仍在高點，配置多短債賺取高殖利率



期待 TLT 價格在降息後能提升



雲端運算產業

- 1 結論
- 2 產業分析
- 3 公司推薦

結論

產業分析

AI 應用拓展導致算力需求大幅增加，全球雲端運算需求強勁成長；IaaS 市場成長突出，亞馬遜、微軟、Google、阿里巴巴四大巨頭寡占市場逾七成份額

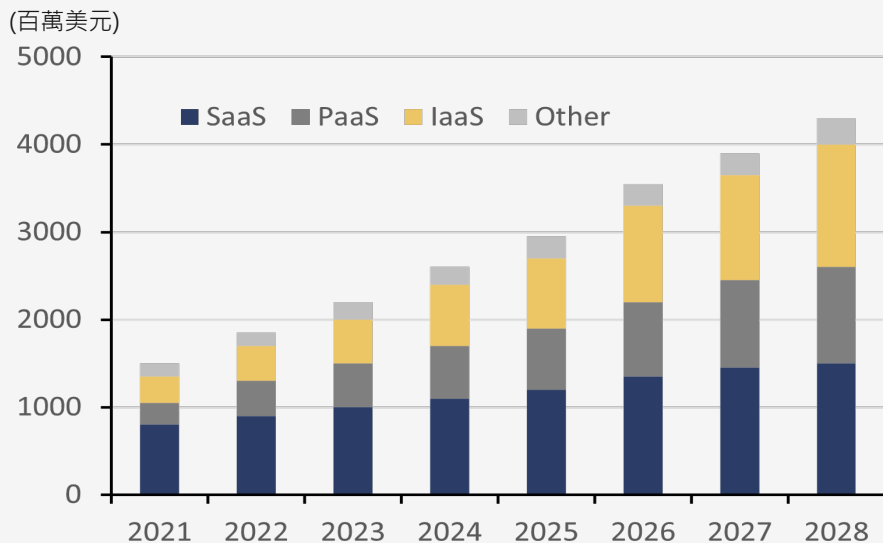
公司推薦

- Google (GOOG) : AI 技術導入有效提升產品附加價值、拉抬廣告營收成長。4 月推出 Gemini 品牌整合完整 AI 生態系，搶攻雲端服務訂閱市場
- Alibaba (BABA) : 電商業務 GMV 大增帶動成長；二度調降雲端產品售價，以價格優勢搶下市佔，同時強化以 ECS g8i 等 AI 技術為核心之科技業務
- 微軟 (MSFT) : 積極整合 AI 與現有產品，4 月推出 AI 新語言模型與資安應用，同時動視暴雪收購促進 Xbox 銷售增加，帶動三大業務營收同步成長
- Amazon (AMZN) : 現有雲端服務市佔第一、積極布局 AI 生態系，已開發潛力產品 Bedrock。持續優化電商物流系統，Prime Video 廣告收入強勁成長

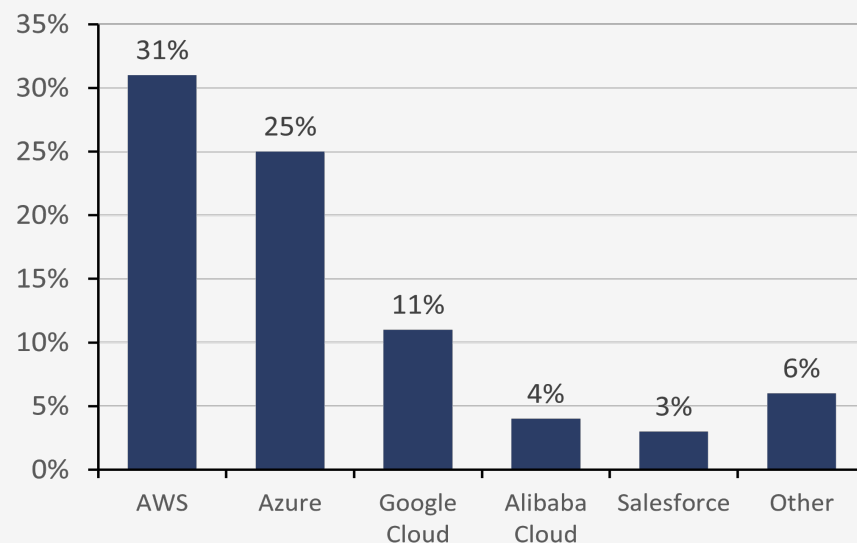
雲端運算市場強勁成長，AI 注入基礎設施與算力需求新動能

- 全球雲端運算需求強勁成長，預計 2029 年市值將由當前 6,800 億美元增至 1.44 兆美元，CAGR 達 16.40%，其中又以 IaaS 類別成長最快，2023 年市值年增 30.9%。
- AI 應用拓展導致算力需求大幅增加，企業擴大對雲端基礎設施投入資本，2023 年相關支出共計 2,700 億美元、全年與 23Q4 單季年增皆為 19%，其中，貢獻主要成長動能。
- 24Q1 以亞馬遜、微軟、Google、阿里巴巴四大廠佔市場份額逾七成，又以 AWS 與 Azure 為最高，阿里雲則以 21.3% 市佔在 IaaS 市場排名全球第三、亞太地區第一。

雲端需求強勁擴增，IaaS 類別成長速度領先



四大巨頭占據份額七成，寡占雲端市場



Amazon

1 公司介紹

2 公司策略

成分股分析 – Amazon (AMZN)

Amazon

主要業務	電商平台、雲端服務
營收 (2023)	143,310 (百萬美元)
市值 (2024)	1.92 (兆美元)
收盤 (5/19)	184.70 美元

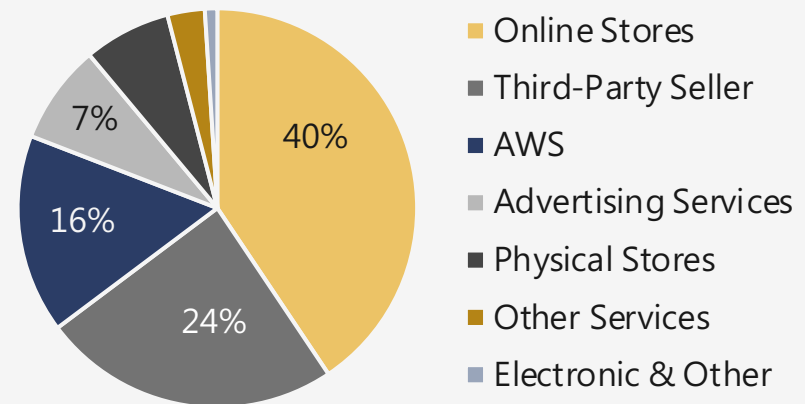
成長動能

- ✓ 受惠企業 AI、雲端產業運算需求提升，同時布局 AI 生態系，以提供企業自訂之生成式 AI 為發展策略。
- ✓ 電商物流系統優化，Prime Video 帶動廣告收入強勁成長。

簡明損益表 (百萬美元)

	2022	2023	2024 (F)
營業收入	513,983	574,785	639,021
毛利率	43.81	46.98	48.47
營業利益率	2.38	6.41	9.90
稅後淨利率	-0.53	5.29	7.62
EPS	-0.27	2.95	4.59

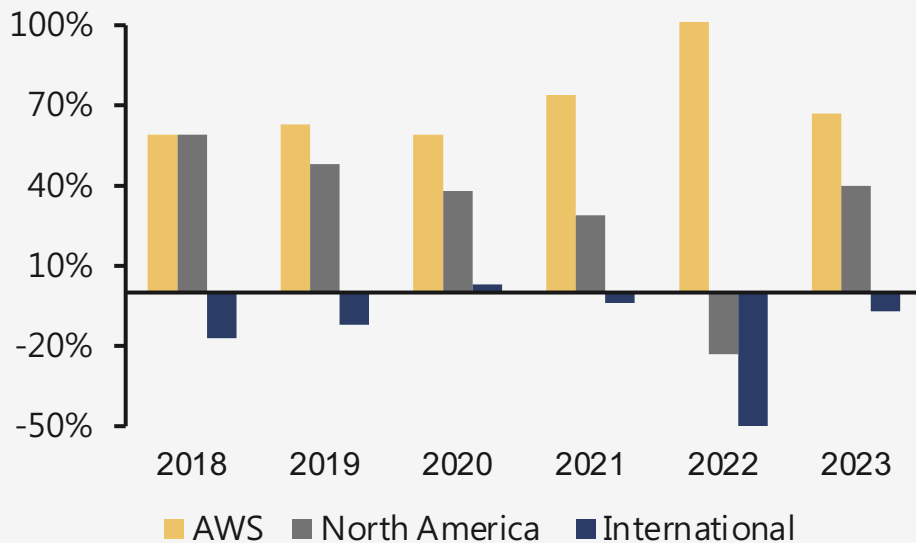
Amazon - 營收占比圖



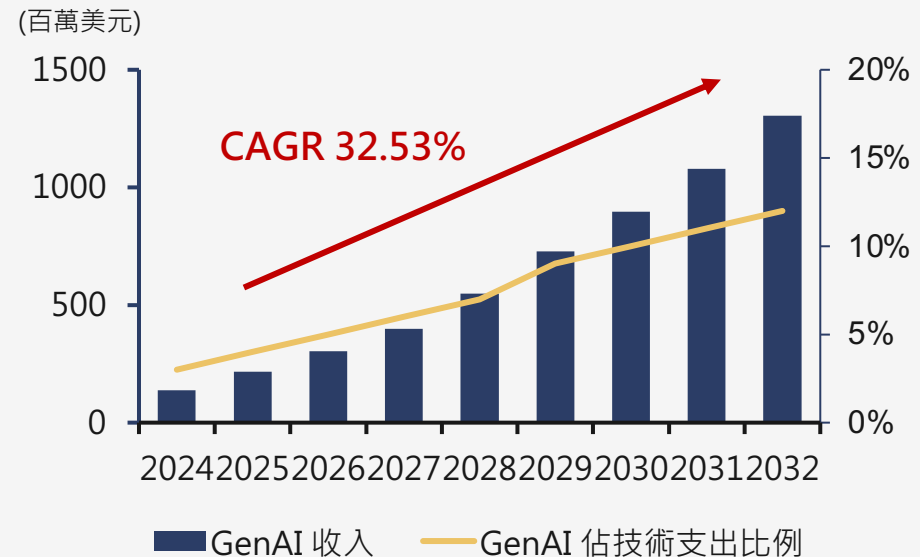
企業雲端需求提升、AI 生態系布局擴張未來 AWS 服務範圍

- AWS 雲端服務市佔第一，在 AI 布局涵蓋上游的大型語言模型 (LLM)，至中游的 Bedrock 平台，再到下游 AI 應用開發。隨著 AI 帶動企業對雲端服務運算、存儲等資源需求提升，AWS 將直接受惠。
- AWS Bedrock 為未來服務重點，強調企業利用自行制定生成式 AI，同時保護企業資訊安全，亦宣布推出 Custom Model Import，允許企業將內部的生成式 AI 模型作為 API 導入平台進行全面管理。
- 電商方面，Amazon 積極搶佔國際市場零售份額，優化物流系統，24Q1 顯示主要城市之交付速度皆創新紀錄；此外，Prime Video 24 年開始插入廣告，同比增長 24%，大量消費者資料及 Prime Video 影響力亦為 Amazon 帶來龐大廣告收益成長空間。

AWS 為營業淨利貢獻達 67% 為成長主力



GenAI 應用成長為 AWS 布局帶來長期動能



Microsoft

- 1 公司介紹
- 2 公司策略

成分股分析 – 微軟 (MSFT.US)

微軟

主要產品	Windows 作業系統、Office 系列軟體、Azure 雲端解決方案等
營收 (2023)	211,915 (百萬美元)
市值 (2024)	3.2 (兆美元)
收盤 (5/22)	429.04 (美元)

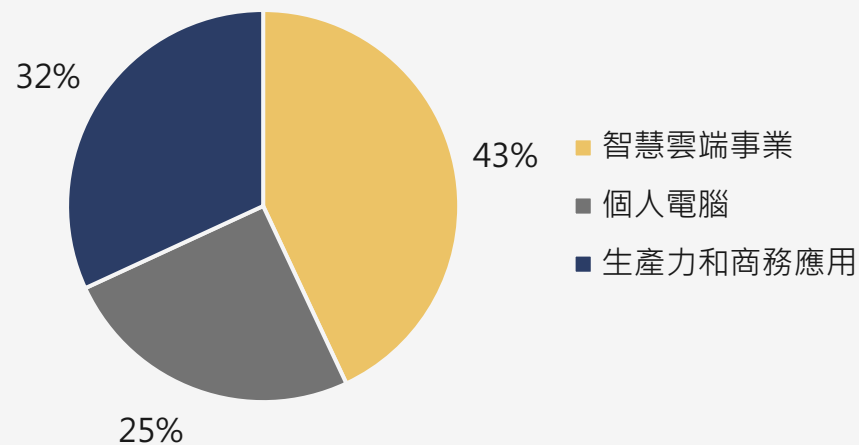
簡明損益表 (百萬美元)

	2021	2022	2023
營業收入	168,088	198,270	211,915
毛利率	68.93%	68.40%	68.92%
營業利益率	41.59%	42.00%	41.76%
稅後淨利率	36.45%	36.69%	34.15%
EPS	8.12	9.70	9.72

成長動能

- ✓ 4 月推出新語言模型及 AI 資安產品，並積極整合 AI 領先技術與現有產品，帶動市佔率、訂閱數與營收同步成長。
- ✓ 動視暴雪收購效益發酵，促進 Xbox 服務銷售成長，有望作為短期營收成長動能。

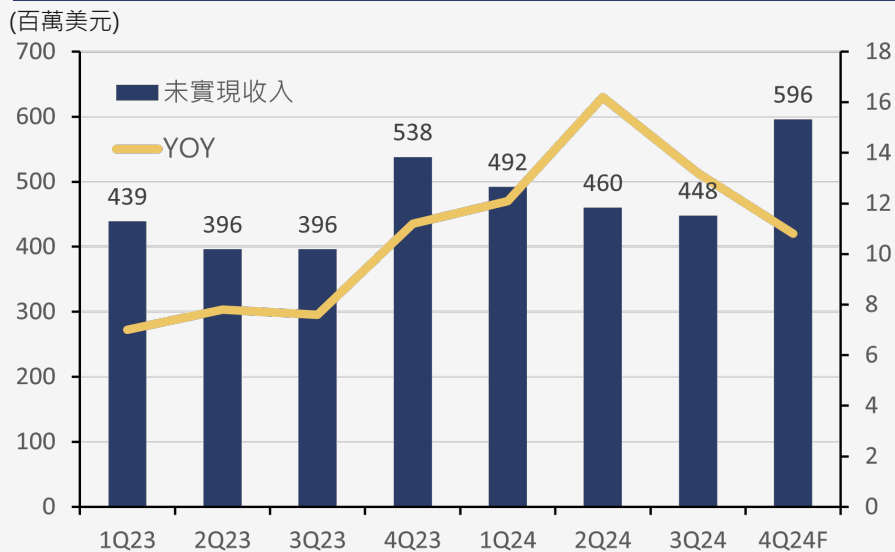
微軟 - 營收占比圖



雲端與軟體服務導入 AI 技術優勢，帶動營運表現強勁

- 三大業務皆為成長，雲端服務 Azure 擁有25% 市場份額、Office 365 與 Dynamics 系列生產力產品亦銷售強勁，23Q3 營收年增 17%，優於市場預期。
- 積極整合 Copilot 與 OpenAI 領先技術與現有產品，帶動 GitHub Copilot 訂閱數季增三成、Azure OpenAI 於全美 500 大企業滲透率提升至 65%，營收分別成長 45% 和 31%。
- 4 月推出 Phi-3 系列小型語言模型及 AI 資安產品 Copilot for Security，同時動視暴雪收購效益發酵，促進 Xbox 服務銷售成長 62%，有望作為短期營收成長動能。

訂閱帶來未實現收入增長，營收前景樂觀



三大業務皆正成長，雲端結合 AI 成長領先

類別	產品	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24
生產力和商務應用	Office 365, Dynamics, LinkedIn	14%	14%	17%	17%	15%
智慧雲端	Server, Cloud, Azure	22%	22%	25%	26%	28%
個人電腦	Windows, Xbox, Search Advertising, Devices	-6%	-3%	3%	15%	15%

Alphabet

- 1 公司介紹
- 2 公司策略

成分股分析 – Alphabet (GOOGL)

Google

主要業務	網路及雲端服務供應商
營收 (2023)	1,303.5 (億美元)
市值 (2024)	20,700 (億美元)
收盤 (5/17)	88.54 美元

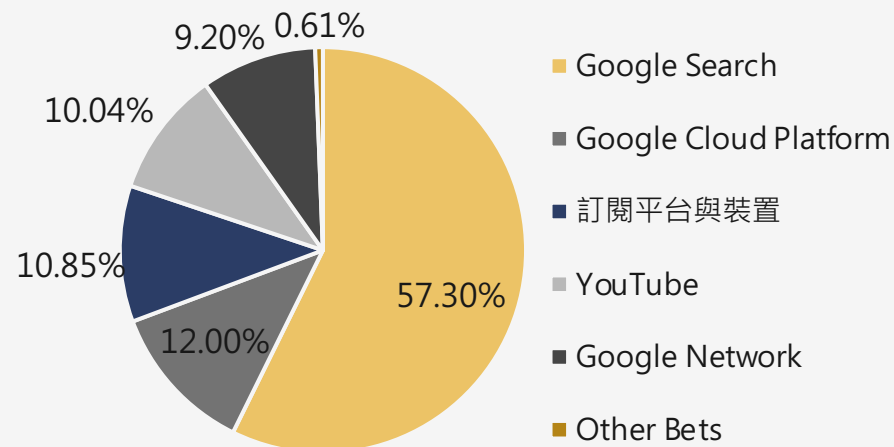
簡明損益表 (百萬美元)

	2022	2023	2024 (F)
營業收入	282,836	307,394	344,578
毛利率	55.37%	56.62%	57.32%
營業利益率	26.46%	27.42%	34.03%
稅後淨利率	21.2%	24.0%	26.1%
EPS	4.59	5.84	8.65

成長動能

- ✓ 短期以導入 AI 技術提升各項業務的效能及附加價值，並大力投資基礎科技設施。
- ✓ 長期受惠企業雲端運算需求增加，並以 Gemini 品牌整合 AI 相關產品，建立完整生態系，有望搶佔更多雲端運算市場。

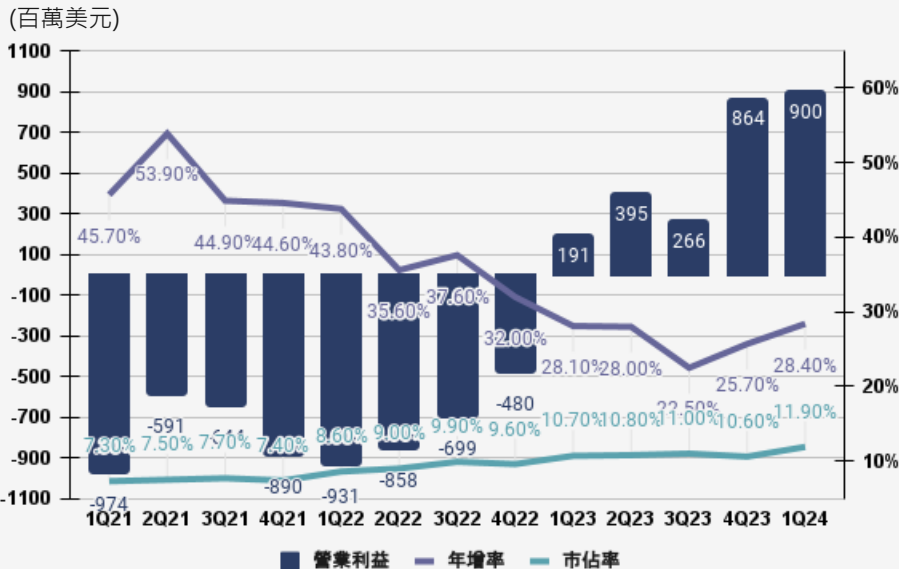
Alphabet – 營收佔比圖



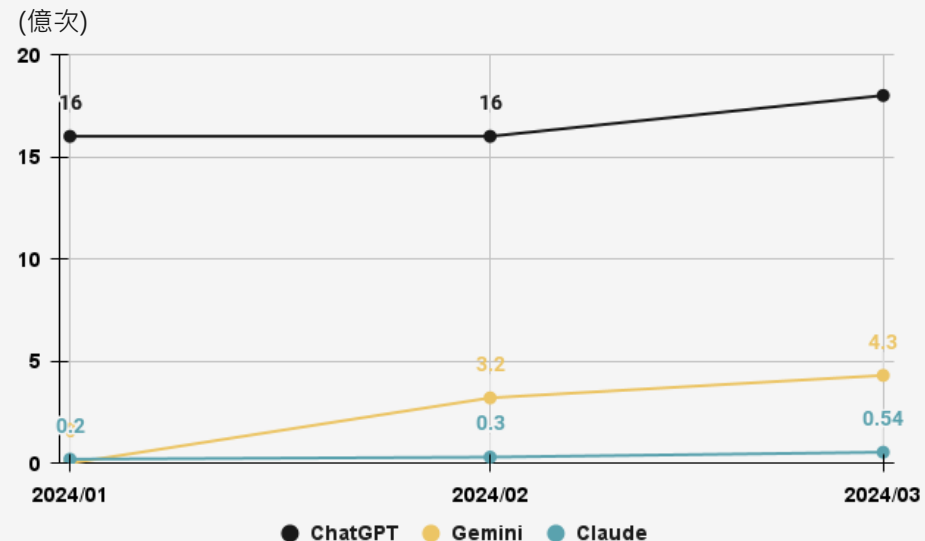
運算需求持續增加，看好雲服務營收成長及 AI 變現能力

- Google Cloud 在雲端市佔率約 11%，24Q1 營收年增 28.4%，近期營收成長來自生成式 AI 代理模式解決方案導入增加、雲端辦公軟體訂閱附加收入使 ARPU 成長、部分產品價格調漲等。2024 年資本支出預計達 480 億美元，主要投資伺服器及資料中心。
- Google Cloud 成長動能包含 AI 品牌 Gemini 整合成效、AI 超級電腦導入輝達 HGX B200 及 GB200 NVL72 供企業訂閱；加速器 TPU v5p 全面與 GKE 互連，提升整合性及彈性；新自研晶片 Axion 有望與其他 CSP 競爭 IaaS 市場，未來三季預期年增 26%。

Google 雲端服務穩定獲利且呈雙位數成長



Gen AI 模型 Gemini 推出後進入快速成長



Alibaba

1

公司介紹

成分股分析 - Alibaba (NYSE: BABA)

阿里巴巴

主要業務	電子商務、支付、雲端運算及網路服務、移動解決方案
營收 (2024)	9,411 (億人民幣)
市值 (2024)	1,821 (億美元)
收盤 (5/22)	84 港幣

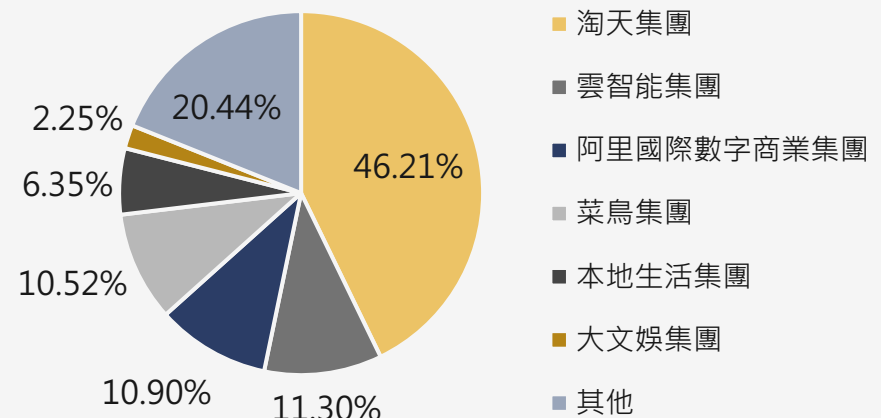
簡明損益表 (億人民幣)

	2022	2023	2024
營業收入	8,530	8,687	9,411
毛利率	36.7%	36.7%	37.7%
營業利益率	11.1%	11.8%	13.1%
稅後淨利率	5.5%	7.54%	7.58%
EPS	22.96	27.68	31.6

成長動能

- ✓ 重燃電商及雲端兩大核心營收：GMV 大增，使電商業務重拾增長；二次調降國外核心雲端產品售價，以價格優勢擴大雲端運算市佔。
- ✓ 長期受惠企業開發 AI 及雲端運算需求增加，著重 AI 驅動的科技業務。如 ECS g8i 提升 AI 推理能力。大力投資公有雲基礎設施。

阿里巴巴 – 營收佔比圖



設備產業

- 1 結論
- 2 成長動能
- 3 公司介紹

結論

產業分析

- 半導體設備為IC 產業重要元素，其未來發展將取決於製程演進
- CoWoS為目前主流應用，目前產能仍供不應求，且應用於大部分AI 晶片，能否供應CoWoS設備將為各廠商決勝點

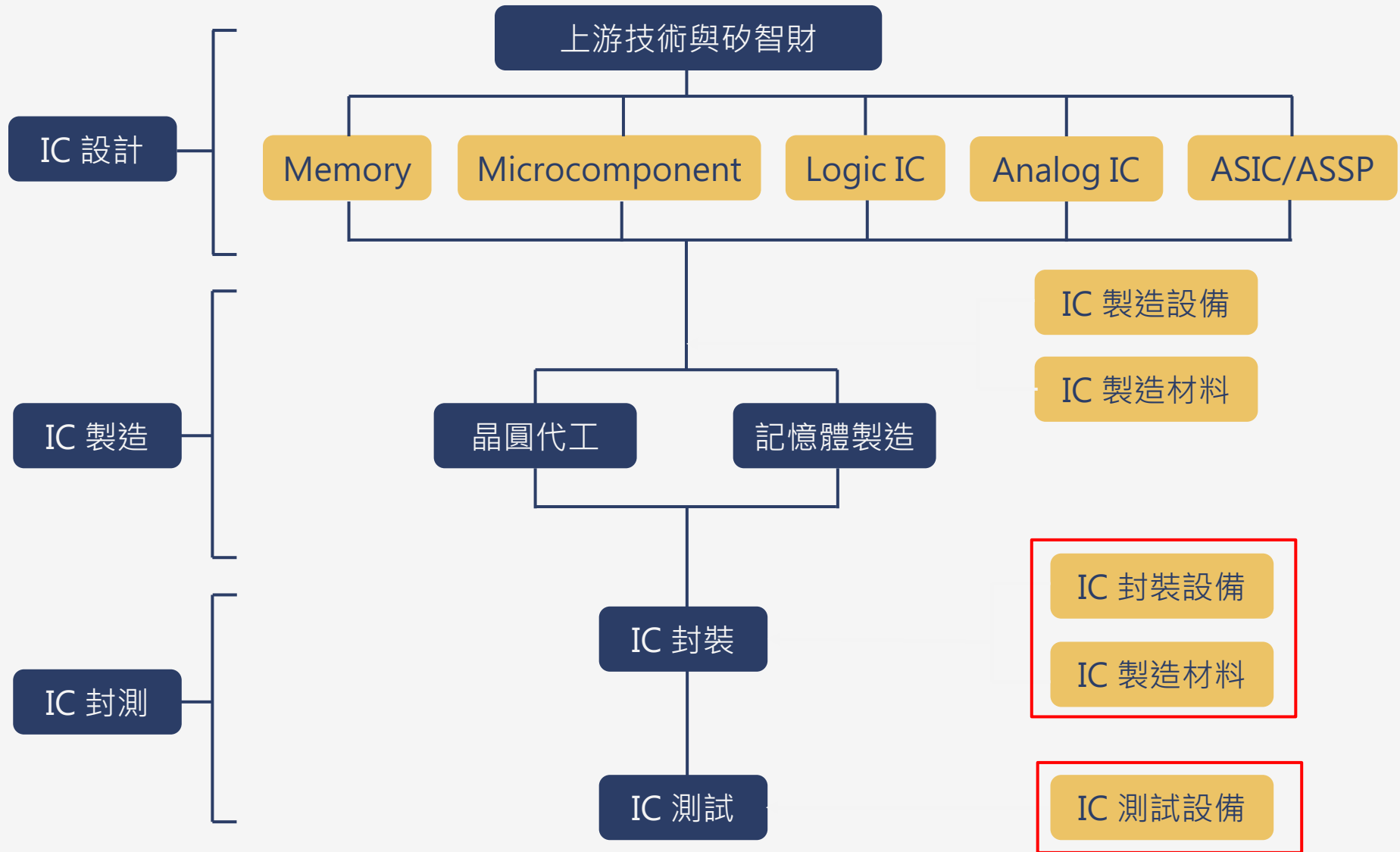
成長動能

- 台積電CoWoS 產能供不應求，公司持續擴張產能，帶動設備產業高速成長
- 日月光持續擴張資本支出，嘗試擴大先進封裝業務，受惠相關設備廠商

公司推薦

- 辛耘 (3583 TT)：受惠CoWoS 產能擴張，設備製造高速成長；成熟製程、SiC、光罩相關設備需求強勁，預計24 年營收/EPS YoY分別達 36% / 57%
- 弘塑 (3131 TT)：相關客戶資本支出擴張，訂單能見度到2Q25
- 牧德 (3563 TT)：受惠日月光大幅提升資本支出，預計2H24將出現營收跳增，預期24/25年 營收YoY 47% / 116%，EPS YoY 37% / 206%

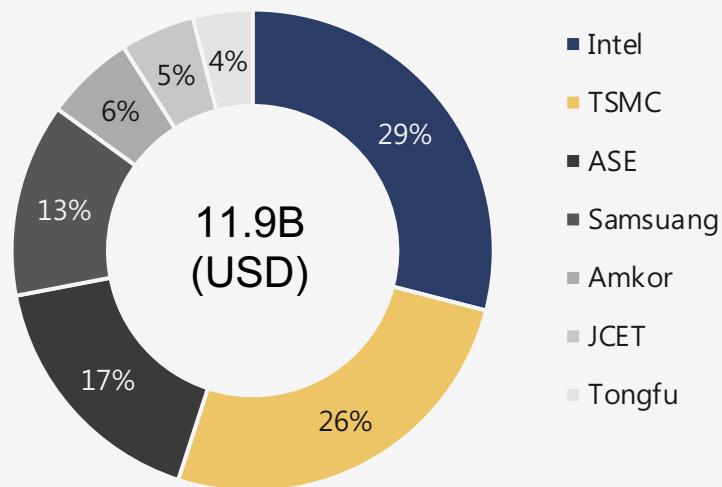
製造設備及材料為IC 產業重要供應，其成長取決於製程發展



先進封裝為半導體發展趨勢，Intel、台積電為賽道領跑者

- 先進封裝把多個晶片以堆疊的方式封在一起，以增加記憶體及處理器間讀寫效能，對5G、AI 等低延遲、高傳輸速度要求之應為甚為關鍵。
- 可分為2.5D 以及3D 封裝，而CoWoS 即為2.5D 封裝，為目前AI 晶片的應用主流，3D 封裝則因成本、良率、散熱等因素尚未普及，目前僅應用在AMD MI300 上
- 從技術及資本支出角度來看，Intel 及台積電投入資本達產業55%，因產業的高資本進入障礙以及從製造到封裝的一站式服務，未來將持續掌握先進封裝主要市場

台積電及Intel 先進封裝投資額佔全球55%



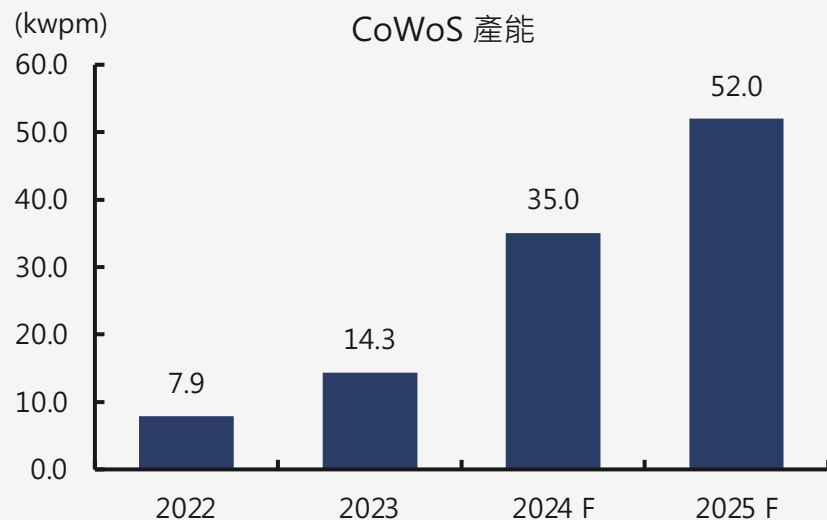
CoWoS 為目前AI 晶片應用主流

技術名稱	InFO	CoWoS	SoIC
技術分類	2D/2.5D	2.5D	3D
成本	低	高	最高
產能佔比	70-80%	15-25%	<5%
應用	Apple A17 M2	Nvidia H100 AMD MI300 AMD Epyc CPU	AMD MI300

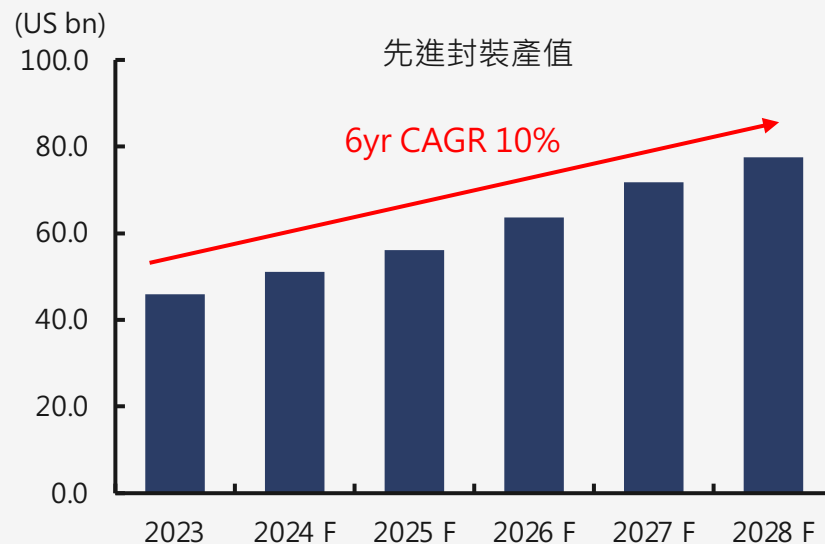
CoWoS 產能供不應求，產能擴充將帶動供應鏈成長

- 根據 Yole 調查，先進封裝產值將由 23 年 461 億美元成長至 28 年 771 億美元，CAGR 10%，其中 CoWoS 應用為主要成長因素
- 而 CoWos 為目前 AI 晶片主流應用，2024 年 Nvidia 預計出貨 375 萬顆 AI 晶片，其中 B100 佔 70 萬顆，H100 佔 260 萬顆，其餘則為 A100，為先進封裝的主要成長動能
- 為因應客戶需求，台積電積極擴充 CoWoS 產能，預期 24 年產能將增加一倍，達 35 kwpm，25 年達 52 kwpm，YoY 144%/48% 將帶動供應鏈廠商成長

台積電積極擴充 CoWoS 產能應對 AI 需求



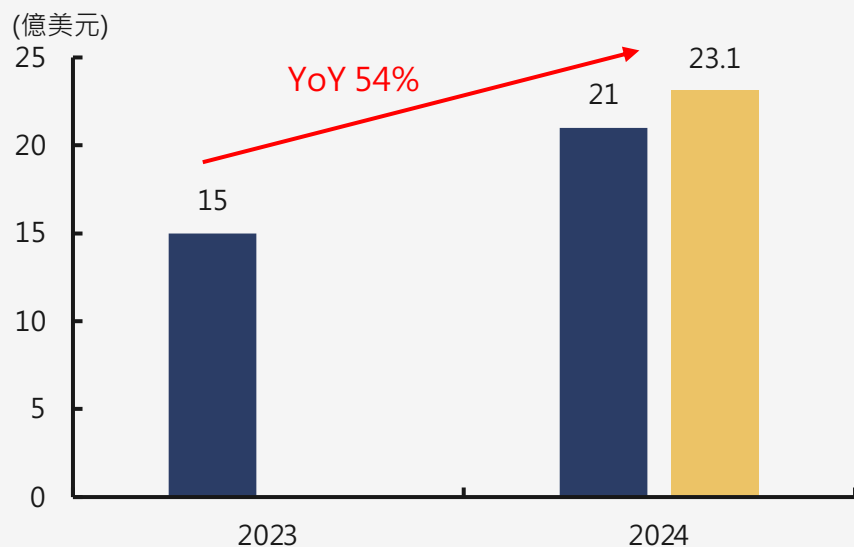
23~28 年先進封裝產值 CAGR 10%



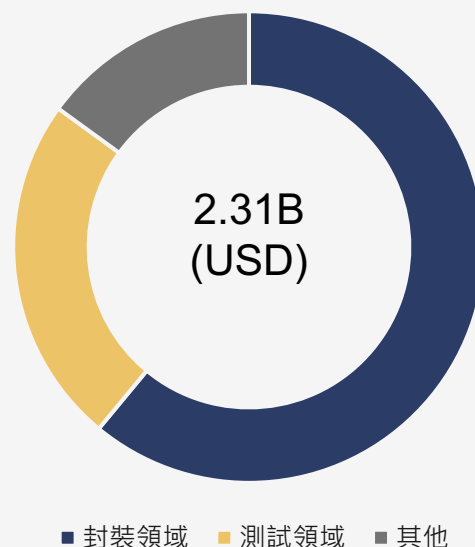
日月光持續擴張資本支出 積極發展先進封裝技術

- 日月光於25日法說會上表示，因AI動能成長強勁，先進封裝產能仍供不應求，為因應半導體領域趨勢，進一步上修24年資本支出，在原訂21億美元的基礎上增加10%，預估24年資本支出將達到23.1億美元，約743億新台幣，YoY 50%以上
- 其中，今年資本支出將有61%用於封裝領域，而測試領域將由原訂18%提升至24%，若用技術等級區分，有50%投入先進技術（包含先進封裝、先進測試），將受惠其設備供應商，包含弘塑、牧德

日月光上修資本支出，YoY超過 50%



超過50%的資本支出投入封裝領域



辛耘

1 公司介紹

2 公司策略

辛耘 (3583 TT)

基本資料

主要業務	設備自製、設備代理、再生晶圓
營收 (1Q24)	2244 (百萬元)
市值	282 (億元)
收盤價	351 (元)

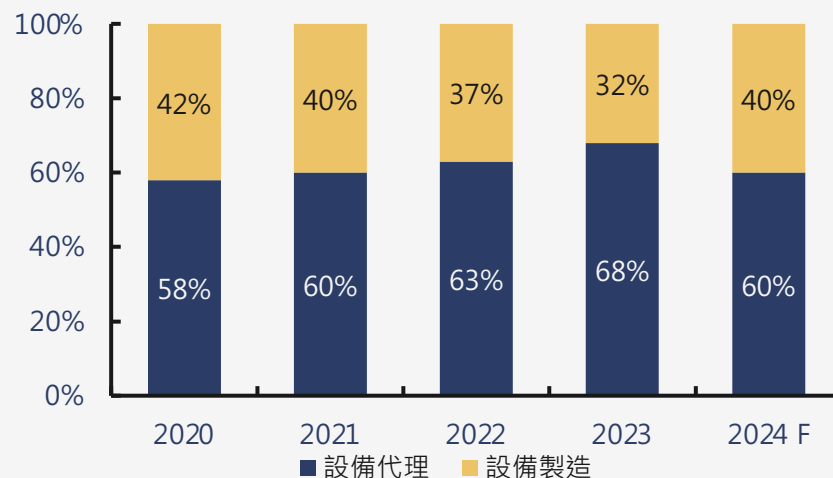
成長動能

- ✓ 受惠於CoWoS 產能擴張，設備製造業務 24 年 YoY 70%，預期佔總營收 40%
- ✓ 成熟製程、SiC、光罩相關設備需求強勁，代理業務24 年 YoY 20%
- ✓ 營收組成改善，預計24 年營收/EPS YoY 分別達 36% / 57%

簡明損益表 (百萬元)

	2022	2023	2024 F
營業收入	5650	6911	9399
毛利率	36.9%	31.8%	32.1%
營業利益率	12.6%	10.4%	13.9%
稅後淨利率	10.1%	9.4%	10.9%
EPS	7.08	8.10	12.75

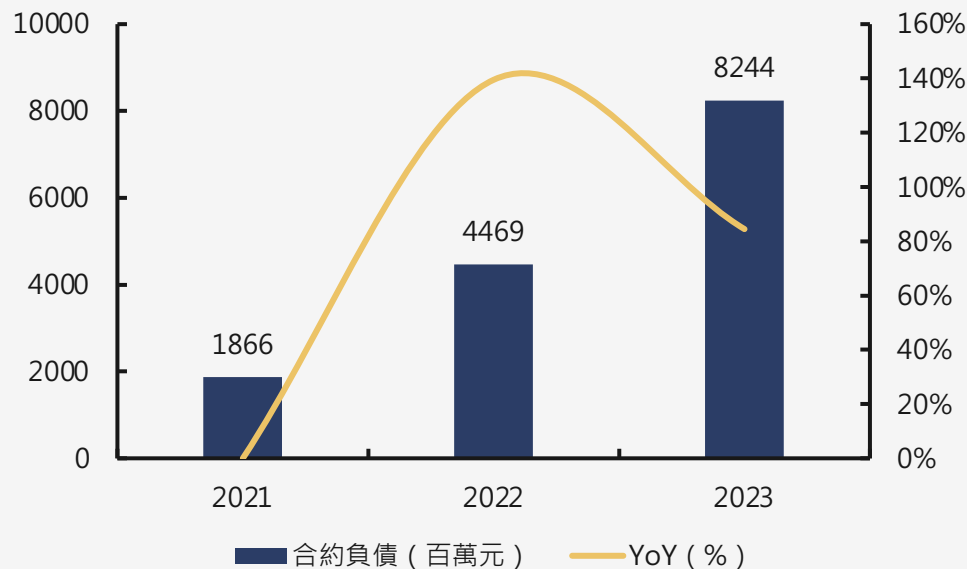
營收組成



設備自製及設備代理部門同步成長，預期營收YoY 36%

- 受惠於CoWoS 產能擴張，台積電及其他同業積極拉貨，設備訂單能見度高，至9M24 後才能生產新訂單，預期設備製造業務24 年 YoY 70%，將佔總營收 40%，且因設備製造毛利率較高，整體毛利率將得到優化
- 中系客戶持續擴張產能，24 年中國客戶訂單動能將延續，主要出貨成熟製程、SiC、光罩等相關設備，且晶片禁令對辛耘影響相對有限，預期24 年設備代理業務 YoY 20%，將佔總營收 60%

合約負債高速成長 公司訂單狀況良好



中系廠商持續擴廠 帶動代理業務成長

客戶	廠區	製程	月產能 (片)
中芯國際	天津西青	28nm以上	100000
	上海臨港	28nm以上	100000
	北京	28nm	100000
華虹半導體	無錫	60/40 nm	80000
合肥晶合	合肥N2	55/40 nm	40000
	合肥N3/N4	N/A	19000

弘塑

- 1 公司介紹
- 2 公司策略

弘塑 (3131 TT)

基本資料

主要業務	濕製程設備
營收 (1Q24)	898 (百萬元)
市值	357 (億元)
收盤價	1225 (元)

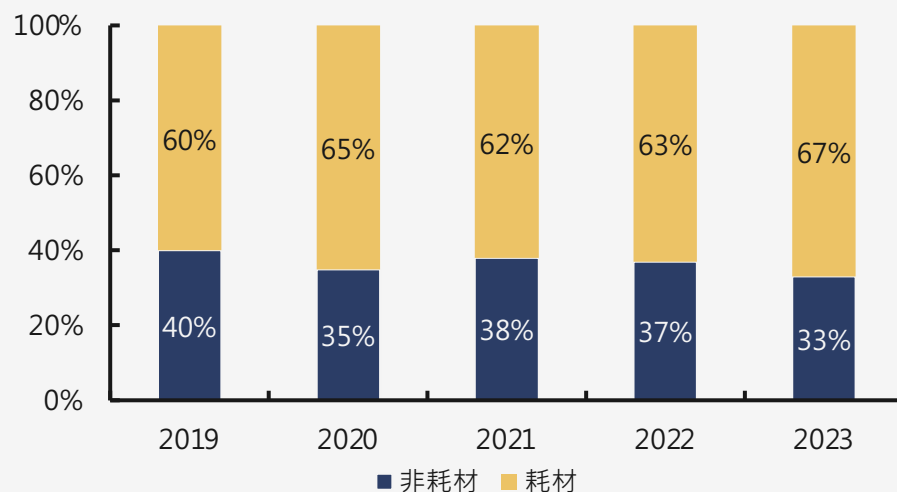
成長動能

- ✓ 受惠於CoWoS 產能擴張，台積電、日月光、Amkor 等客戶持續上修資本支出，訂單能見度至 2Q25
- ✓ 濕製程設備技術佔據領先地位，可供應 SoIC 製程設備

簡明損益表 (百萬元)

	2022	2023	1Q24
營業收入	2014	1626	898
毛利率	42.4%	46.9%	43.2%
營業利益率	19.6%	22.0%	19.3%
稅後淨利率	35.8%	37.9%	19.0%
EPS	25.32	21.56	5.99

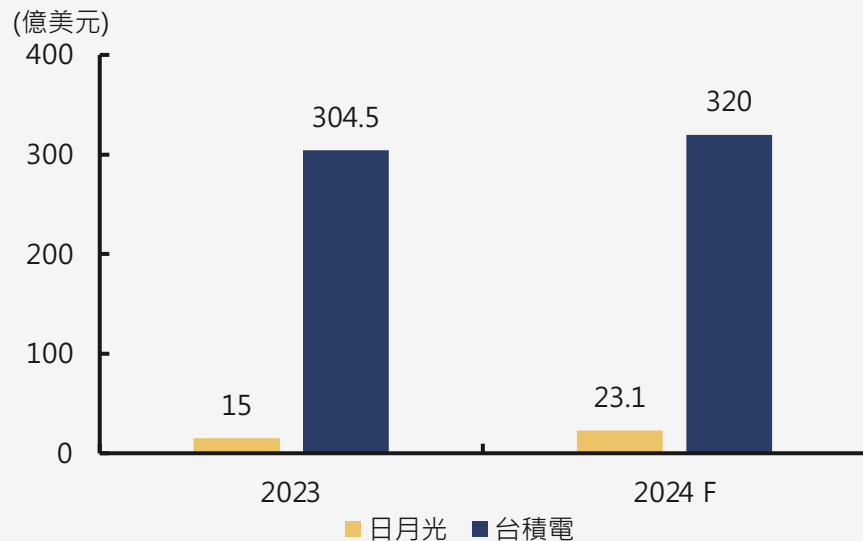
營收組成



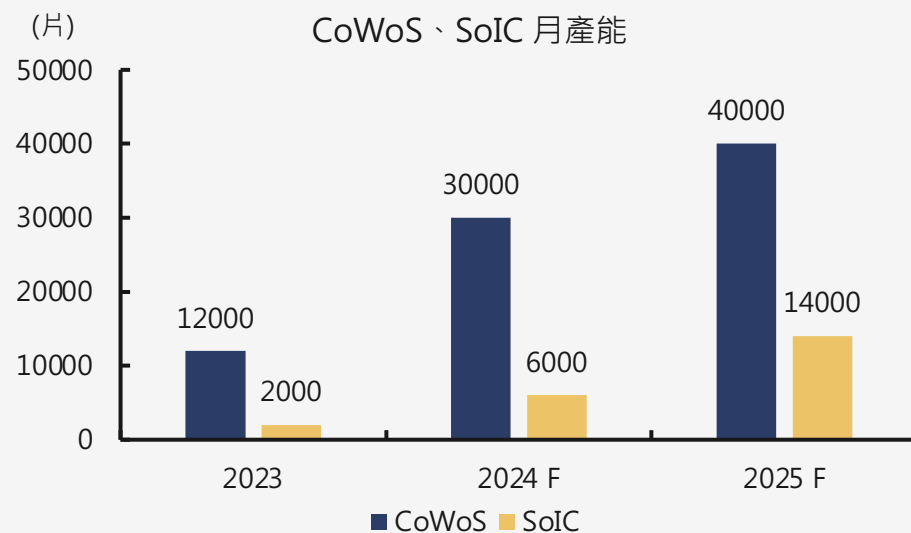
處於技術領先地位且同時出貨多家客戶，訂單能見度高

- 在先進封裝領域中，弘塑主要出貨濕製程設備，主要供貨產品有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)，且弘塑同時跨足蝕刻、光阻去除製程，在台積電以外，同時掌握日月光、美光、Amkor 等客戶訂單能見度高
- 業界預測24 年底CoWoS 月產能將達到3~3.4 萬片，25 年則達4.4~4.6 萬片；SoIC 部分，23 年月產能約 2000片，24 年預期達6000 片，目標25 年達到1.4~1.5萬片，而弘塑在 SoIC 設備上具有領先地位，未來將做為SoIC製程 第一批供應商

客戶資本支出持續提升 訂單能見度高



SoIC 產能持續擴張 弘塑具有技術優勢



牧德

1 公司介紹

牧德 (3563 TT)

基本資料

主要業務	AVI、AOI 檢測設備
營收 (1Q24)	267 (百萬元)
市值	234.6 (億元)
收盤價	403.5 (元)

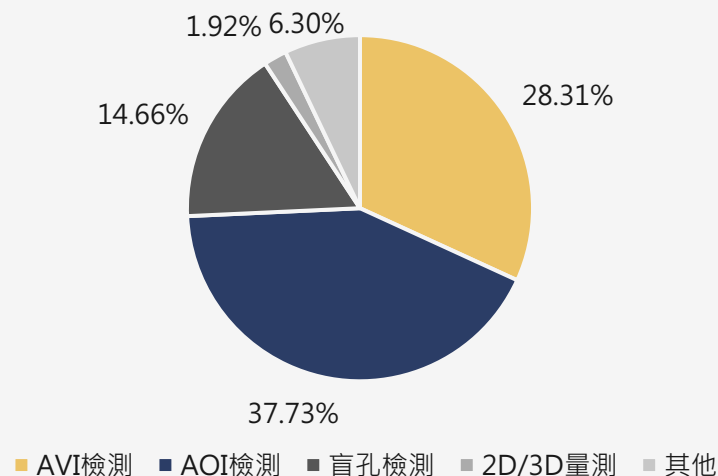
簡明損益表 (百萬元)

	2023	2024F	2025 F
營業收入	1584	2334	5059
毛利率	54.5%	56.5%	60.0%
營業利益率	26.7%	28.3%	45.0%
稅後淨利率	26.8%	28.1%	40.0%
EPS	8.21	11.28	34.55

成長動能

- ✓ 日月光大幅提升24年資本支出至23.1億美元，將直接受惠牧德
- ✓ 透過私募結盟日月光，合作開發檢測設備，預計2H24開始交貨，營收有望跳增，預期24/25年 營收YoY 47% / 116%，EPS YoY 37% / 206%

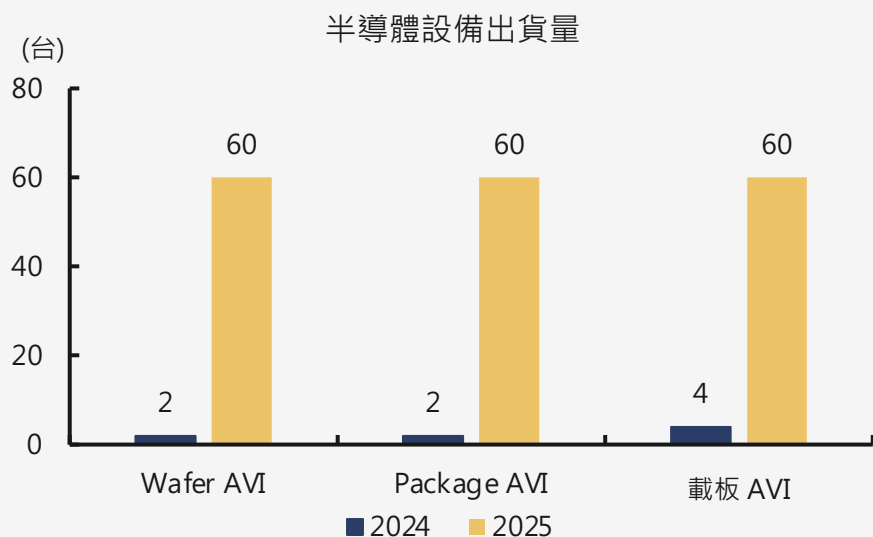
營收組成



大客戶擴張資本支出，牧德將成最大贏家

- 大客戶日月光表示因AI 動能成長強勁，先進封裝產能仍供不應求，進一步上修24 年資本支出，預估24 年資本支出將達到 23.1億美元，約743 億新台幣，YoY 50% 以上
- 牧德目前開發三款設備，分別是Wafer AVI、Package AVI、載板AVI，三款設備的ASP 分別為10~13m/15~30m/15~20m美金，Wafer AVI 目前已出貨2 台，Package AVI 則在4M24 推出兩面檢測，預期於9M24 推出四面檢測，而載板AVI 已出貨4台，且預期三種設備25 年出貨量皆為60 台，預期24/25年 營收YoY 47% / 116%，EPS YoY 37% / 206%

25 年設備出貨量將大幅增長



半導體設備之ASP 遠高於PCB 設備

